

tesa[®] HAF 8440

Thông Tin Sản Phẩm



Băng keo HAF màu trắng mờ, dày 40µm

Product Description

tesa[®] HAF 8440 là băng keo kích hoạt kết dính do nhiệt, hai mặt trong mờ gốc copolyamide hóa dẻo.

Đặc tính kỹ thuật:

- Gắn chip với độ tin cậy cao
- Thích hợp cho thẻ PVC, ABS và thẻ PC
- Thao tác tốt trên tất cả các dây chuyền dập thẻ thông dụng
- Độ bền cao
- Băng keo ẩn trong thẻ

Đặc trưng

- Gắn chip với độ tin cậy cao
- Thích hợp cho thẻ PVC, ABS và thẻ PC
- Thao tác tốt trên tất cả các dây chuyền dập thẻ thông dụng
- Độ bền cao
- Băng keo ẩn trong thẻ

Ứng dụng

tesa[®] HAF 8440 được thiết kế đặc biệt để gắn mô-đun chip vào thẻ thông minh.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|------------|-------------|----------------------------|----------|
| • Lớp nền | không | • Vật liệu lớp lót (liner) | glassine |
| • Loại keo | copolyamide | • Độ dày | 40 µm |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- Độ kết dính (lực kéo trượt động) 12 N/mm²

Thông tin thêm

Thông tin kỹ thuật:

Các giá trị sau đây là các khuyến nghị cho các thông số máy hoạt động. Xin lưu ý rằng các thông số máy tối ưu phụ thuộc nhiều vào loại máy, vật liệu làm thẻ và chip, cũng như yêu cầu của khách hàng.

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=8440>

tesa® HAF 8440

Thông Tin Sản Phẩm

Thông tin thêm

1. Công đoạn dán ép - bước đầu:

Trong quá trình Công đoạn dán ép - bước đầu, băng keo được ép lên băng chuyền module. Bước này có thể thực hiện trên chuyền hoặc ngoài chuyền. Công đoạn này không ảnh hưởng đến thời gian sử dụng của băng keo.

Điều kiện:

- Nhiệt độ 130-140 ° C
- Lực ép 2-3 bar
- Thời gian 2,5 m / phút.

2. Gắn module:

Trong quá trình gắn module, các module đã được dán ép là các miếng diecut lấy từ băng chuyền module, định vị vào trong khoang thẻ và kết dính cố định với tấm thẻ bằng nhiệt và lực ép. Trong công đoạn này, việc xử lý chính xác tùy thuộc vào loại dây chuyền dập thẻ được sử dụng. Tùy thuộc vào loại dây chuyền dập thẻ, có thể sử dụng một công đoạn hay nhiều công đoạn. Ngày nay, hầu hết các máy dập thẻ có nhiều công đoạn thông dụng hơn.

Quy trình một công đoạn:

Điều kiện:

- Nhiệt độ¹ 180-220 ° C
- Lực ép 65 N / module
- Thời gian 1,5 giây.

Quy trình nhiều công đoạn (2 hoặc nhiều lần gia nhiệt)

Điều kiện:

- Nhiệt độ¹ 180-220 ° C
- Lực ép 65 N / module
- Thời gian 2 x 0,7 giây / 3 x 0,5 giây

Nhiệt độ được đo bên trong khuôn gia nhiệt. Khuyến nghị điều chỉnh nhiệt độ khác nhau cho vật liệu thẻ khác nhau:

PVC 180-190 ° C

ABS 180-190 ° C

PET 190-200 ° C

PC 200-220 ° C

Với những ứng dụng ngoài gắn chip vào thẻ, thì có thể áp dụng các thông số máy cho máy khác nhau. Giá trị độ kết dính đạt được trong điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn. Giá trị đảm bảo giới hạn khi kiểm tra với từng lô sản xuất (Chất liệu: nhôm / điều kiện kết dính: Nhiệt độ= 120 ° C; Lực ép = 10 bar; thời gian = 8 phút).

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=8440>

tesa® HAF 8440

Thông Tin Sản Phẩm

Thông tin thêm

Điều kiện bảo quản theo quy định thời hạn sử dụng của dòng sản phẩm tesa® HAF

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách



để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=8440>